



kingston.com/emcp

eMCP

La solution de stockage intégrée à faible consommation d'énergie parfaite pour les applications mobiles, IoT et embarquées.

Kingston propose une gamme de composants eMCP conformes à la norme JEDEC. L'eMCP intègre le stockage sur carte multimédia embarquée (e•MMC) et la DRAM LPDDR (Low-Power Double Data Rate) dans un boîtier multipuce (MCP) compact. Cette solution permet une plus grande intégration, réduisant ainsi la taille globale. L'eMCP est un composant de stockage et de mémoire combiné, idéal pour les systèmes à espace restreint tels que les smartphones, les tablettes, les appareils portables et divers appareils de l'IoT (Internet des objets).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Solution NAND flash gérée qui simplifie la conception et la maintenance des produits avec une interface eMMC conforme aux normes de l'industrie. Cela réduit considérablement la complexité de la conception et le cycle de qualification.
- La combinaison de mémoire et de stockage hautement intégrés réduit l'espace sur la conception du système, ce qui fait de l'eMCP une solution idéale pour les applications à format réduit.
- La DRAM basse consommation réduit la consommation d'énergie globale, faisant de l'eMCP une solution optimale pour de nombreuses applications alimentées par batterie, telles que les appareils portables et les produits IoT mobiles.
- Complexité de la nomenclature réduite grâce à la réduction du nombre de composants.
- Plusieurs configurations de firmware disponibles pour répondre au mieux aux exigences de votre application en matière de performances, de puissance et de durée de vie.

SEGMENTS COMMERCIAUX



Smartphones et Tablettes



Appareils portables



Accélérateurs d'IA



Internet des objets

eMCP RÉFÉRENCES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS

eMCP basé sur LPDDR3

Référence	Capacité		Standard		Package	FBGA	Température de fonctionnement
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5 x 13 x 1	221	-25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1	221	-25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1	221	-25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1	221	-25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1	221	-25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1,1	221	-25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5 x 13 x 1,1	221	-25°C ~ +85°C

eMCP basé sur LPDDR4x

Référence	Capacité		Standard		Package	FBGA	Température de fonctionnement
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,8	149	-25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5 x 13 x 1	254	-25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5 x 13 x 1	254	-25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5 x 13 x 1	254	-25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5 x 13 x 1	254	-25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5 x 13 x 1,1	254	-25°C ~ +85°C